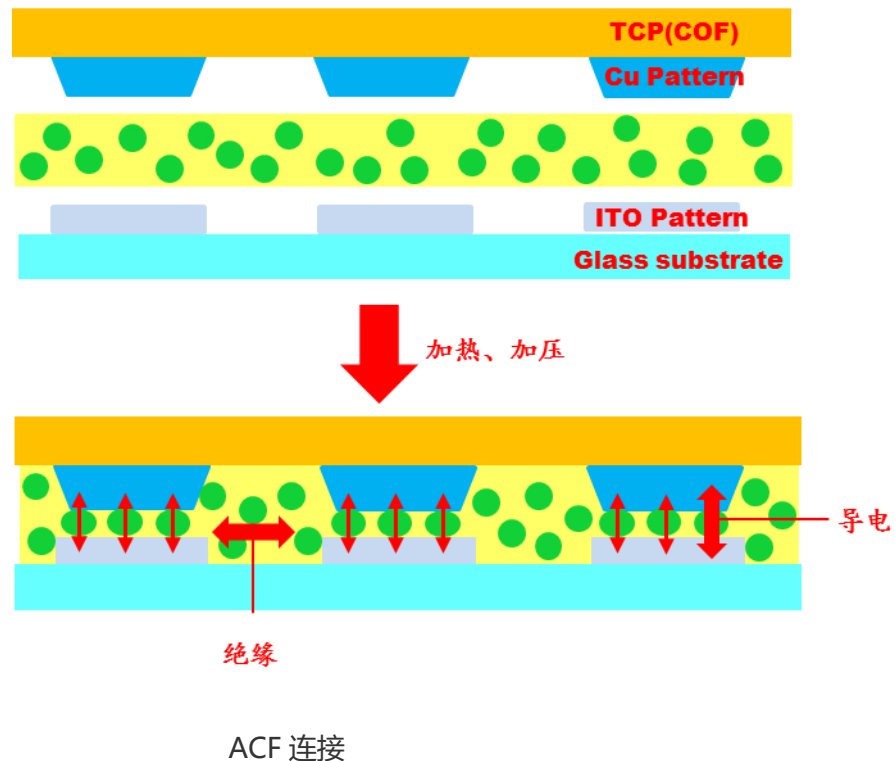


FaraBead®导电金球

FaraBead®导电金球简介

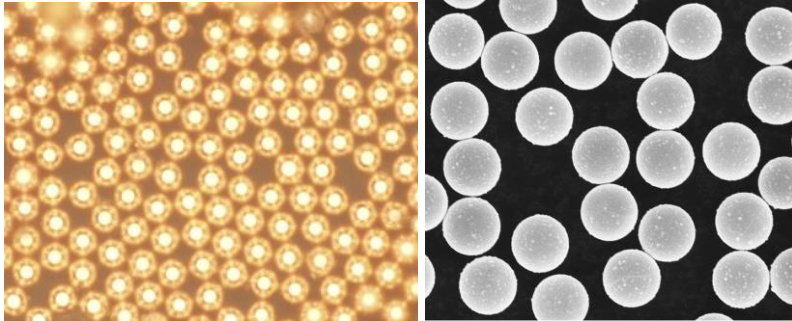
纳微科技生产的高品质 FaraBead® 导电镀金微球广泛应用于微电路连接。FaraBead® 导电金球具有粒径均一，导电性高，合适的弹性和极强的金属壳与树脂核之间结合力等优点。FaraBead® 导电金球为微间距电极之间的连接而设计，如两个液晶显示面板上的玻璃板之间的垂直传导；FaraBead® 导电金球分散于粘结剂中制备各向异性导电膜（ACF）；或各向异性导电胶（ACP）应用于液晶显示器的组装。FaraBead® 是纳微导电球注册商标，FaraBead® 导电球已获得 9 项国家发明专利授权。



FaraBead®导电金球特点

- ◆ 以单分散聚合物微球为核，金层为外壳
- ◆ 广泛的粒径选择：3.0–11.0 μm ，每 0.25 μm 为一个产品规格
- ◆ 粒径均一，变异系数 CV 小于 3.5%
- ◆ 分散性好，无重叠或团聚

- ◆ 合适的硬度，使其具有稳定的导电性和可靠性
- ◆ 阻抗小，在高温高湿下稳定性高



FaraBead® 导电金球光学显微镜和 SEM 电镜图

基本性能参数

密度, g/cm ³	~1.7
热膨胀系数, 10 ⁻⁵ °C ⁻¹	5-7 (核), 1.3-1.4 (金属)
体积电导率 (10 kg/10 mm diameter cell), Ω cm	< 1×10 ⁻²

FaraBead® 导电金球产品规格和分类

产品系列	粒径	规格间隔	CV	K 值 (10% 变形)	金属层 厚度	金属 重量比	应用
	μm	μm		kgf / mm ²	nm	%	
GD	7.00-11.00	0.25	≤3.5%	~450	100-150	30-55	LCD 边框
	3.00-6.75	0.25	≤3.5%	~500	100-150	50-80	
GDL	7.00-11.00	0.25	≤3.5%	~250	100-150	30-55	ACF, ACP
	3.00-6.75	0.25	≤3.5%	~300	100-150	50-80	

联系方式:

苏州纳微科技股份有限公司

地址: 苏州工业园区百川街 2 号, 215123

电话: (86) 0512-6295 6000 或 400-828-1622

Fax: (86) 0512-6295 6018

邮箱: info@nanomicrotech.com

Http://www.nanomicrotech.com

扫一扫, 更多精彩

